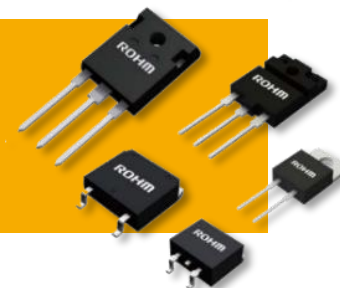


インターンシップ開催のお知らせ



半導体分野の最先端技術に触れ
未来を創造する1week実習型インターン

2022.8/28(日) → 9/3(土)開催

- 対象者
 - ・ 4年制大学の学部（3年生）、修士（1年生）、博士（2年生）
 - ・ 工業高等専門学校の本科4年生または、専攻科1年生
- 開催場所
 - ・ 京都本社（京都市右京区西院溝崎町21）
 - ・ 京都テクノロジーセンター（京都市下京区東塩小路579-32）
 - ・ 横浜テクノロジーセンター（横浜市港北区新横浜2-4-8）
- 実習内容
 - ・ 機械学習を援用した電子デバイス接合の最適化に関する研究
 - ・ 車載パワーマネジメントICのデジタル開発業務
 - ・ 最新SiCデバイス 第4世代 SiCMOSの特性評価
 - ・ 3Dセンシング用レーザー光源の評価
 - ・ 画像認識による個体識別ソフトのアルゴリズム改善とウエハFABでの検証 など
- 備考
 - ・ 交通費、昼食代の支給いたします（ともに弊社基準額）
 - ・ 遠方の方につきましては、宿泊施設を提供いたします
- 申込方法
 - ・ 下記のURLまたはQRコードよりお申込みください。
https://job.axol.jp/jn/s/rohm_24/entry/agreement
 ※詳細な日程はエントリー者へお伝えします。

